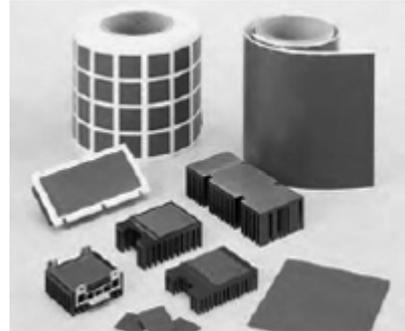


相变导热绝缘材料

相变导热绝缘材料，主要用于高性能的微处理器和要求热阻极低的发热元件，以确保良好散热。相变导热绝缘材料在大约 45~50°C 时会发生相变。并在压力作用下流进并填充发热体和散热器之间的不规则间隙，挤走空气，以形成良好导热的界面。



应用场合:

- * 微处理器、存储模块和高速缓冲存储器芯片
- * DC/DC 转换器、IGBT 和其它的功率模块
- * 功率半导体器件、固态继电器、桥式整流器

性能参数

指标	T710	HF225UT	HF625
厚度 (mm)	0.13	0.077	0.127
相变温度 °C	45	55	65
热阻抗 @5PSI, °C-in ² /watt	0.07	0.05	0.25
导热率 watt/m-k	0.7	0.7	1.0
体电阻 Ω-cm	5x10 ¹⁶	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰
介质强度 v/mil	1.15		
颜色	浅灰	黑	绿

相变衬垫是采用成卷包装，长度为 100 英尺，标准宽度为 25.4 毫米，另有多种规格可选。

使用方法:

- 第一步：采用不脱毛棉球（棉布）沾上酒精//异丙基溶剂，擦干净散热器表面。
- 第二步：撕下相变衬垫上的透明保护膜，将其贴在散热器上。
- 第三步：用手指轻轻压紧超相变阻衬垫导热衬垫。
- 第四步：用手撕下相变衬垫上的蓝色保护膜，将器件压在上方。

WWW.REINTECH.CN

地址：北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com